

lxmall
万联芯城
www.wxmall.com

快速参考指南 高速背板互连解决方案

更快数据速率的出现以及信号上升时间的减少需要更好的表演高速连接器。TE Connectivity广泛的高速组合背板连接器为系统设计人员提供了解决这些问题所需的灵活性具体的性能挑战。

印度的应用

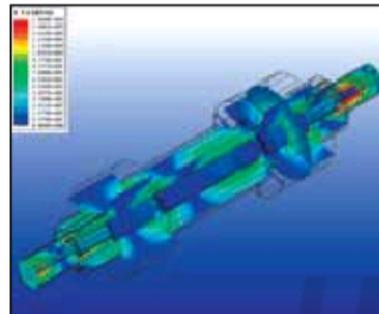
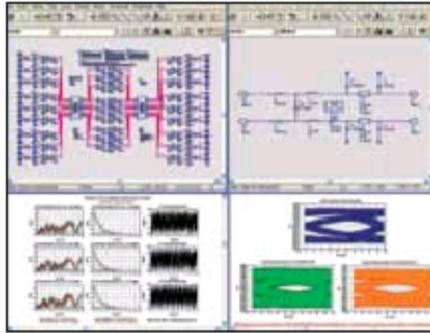
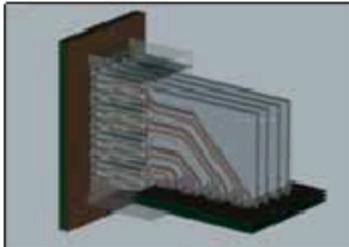
- 服务器 - 刀片服务器，机架安装和大型机可堆叠，电信级，核心，边缘和城域以太网
- 开关 - 可堆叠，电信级，核心，边缘和城域以太网
- 路由器 - 边缘，核心，企业级，电信级以太网，BRAS和多服务边缘
- 光传输：运营商级光学，城域WDM，光多业务配置，长途光学和企业LAN光纤以太网

信号完整性在TE

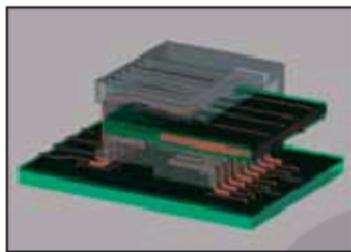
TE Connectivity通过将系统级信号完整性设计专业知识应用于每个高速产品，从连接器中获得最佳性能。我们的模拟和模拟技能在美国，欧洲和亚洲都享有全球专业知识。我们的全球影响力模拟，建模和系统布局专家。

建模和仿真

在TE，设计过程从信号完整性开始。信号完整性工程师使用复杂的3D工具来提供精确的连接器和尺寸通过生产前的图案性能。TE拥有获得正确答案的工具和专业知识。



- ▣ Ansys HFSS和CST微波工作室全波3D工具
- ▣ 连接器和占位面积通过分析的模式在生产之前
- ▣ S参数和SPICE分析
- ▣ 复杂的ADS和MATLAB系统分析



测试能力

凭借超过12.5 Gbps和50 GHz的测量能力，TE可以为其产品提供特征描述和详细测量。前沿测量校准技术和电路板设计可实现测试夹具的准确去嵌入。TE还与众多硅片制造商合作，公司提供主动设备测量，这对于确保设计的成功实施具有无法估量的价值。

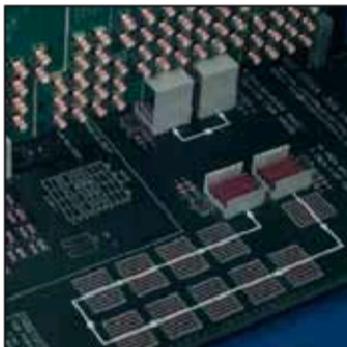
- ▣ 先进的校准技术去嵌入夹具
- ▣ 频率范围为50 GHz
- ▣ 时域眼图/ BERT到12.5 Gbps
- ▣ 有源硅测试 - 多个供应商2 - 10+ Gbps
- ▣ 系统和“仅连接器”板



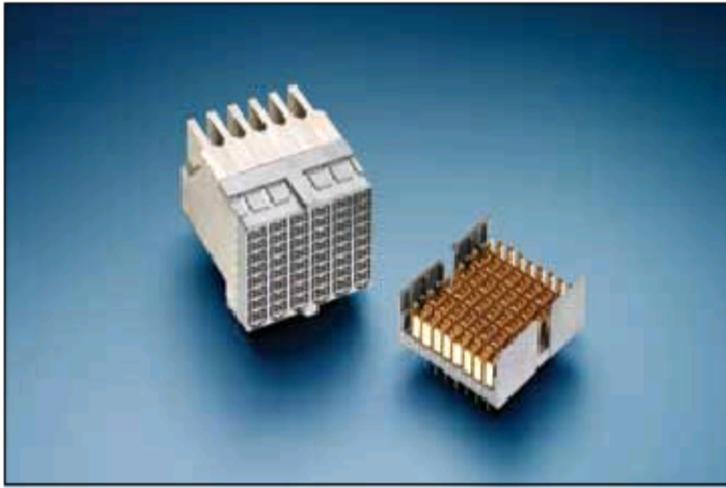
客户支持和工具

从测试板到仿真模型，TE提供了一个帮助您成功实现系统的工具库。

请求可以通过我们的信号完整性网站轻松完成：www.te.com/documentation/electrical-models



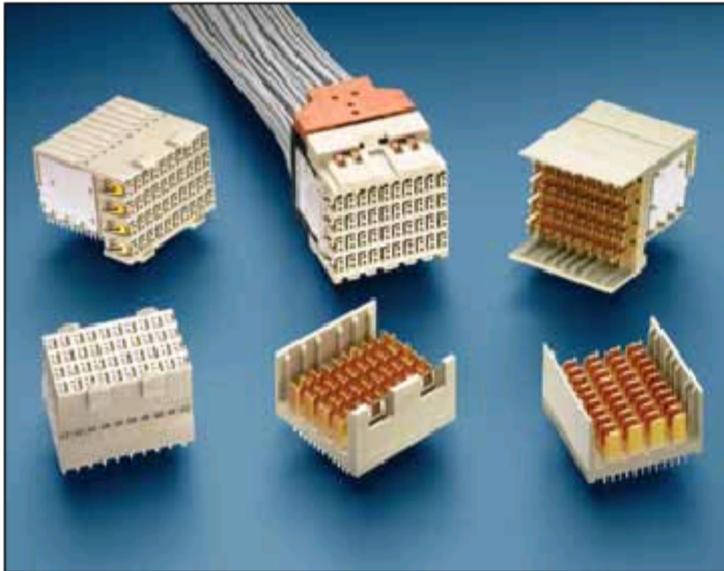
- ▣ Ansys HFSS和CST Microwave Studio全波3D工具
- ▣ 之前分析过的连接器和通过模式的印迹生产
- ▣ S参数和SPICE分析
- ▣ 先进的ADS和MATLAB系统分析
- ▣ 基于测量的S参数连接器型号（64+端口）
- ▣ 基于建模的S参数连接器型号（64+端口）
- ▣ 通过模式S参数和SPICE模型进行占位
- ▣ SPICE连接器型号
- ▣ 连接器评估测试板
- ▣ 系统测试板



STRADA Whisper 连接器

- 高达 40 Gb/s 的性能
- 每厘米密度高达 20 个差分对 (每个 52 DP)
- 可提供 4、6 和 8 对/列，支持卡片 16.4mm (.64")，20.4mm (.8") 和 25.4mm (1") 分别
- 有关代表性部件号，请参阅后面板
- 网站：www.te.com/products/stradawhisper





Z-PACK HM-Zd和Hm-Zd Plus连接器

- 高达12.5 Gb / s的性能
- 密度高达每厘米16个差分对（40 DP每英寸），25.4 mm（1"）槽间距
- 可提供2对，3对和4对/列，适合20.32毫米（0.8"）的槽距
2对和3对版本以及25.4毫米（1英寸）插槽间距
- HM-Zd Plus在设计中向后提供增强的信号完整性
与标准HM-Zd兼容
- 先进的差分结构（ADF）连接器在PICMG 3.X中指定
高级TCA规范
- 有关代表性部件号，请参阅后面板
- 订购目录1773095，“高速背板连接器”
- 网站：<http://hmzd.te.com>



Z-PACK HS3连接器

- 高达6.25 Gb / s的性能
- 每厘米电路板空间可容纳多达40条高速信号线（20 DP），英寸
25.4毫米（1"）槽距
- 有两种版本：六排和十排，分别装配20.32毫米
（0.8"）和25.40毫米（1"）槽距
- 高速连接器设计用于单端和差分
信号
- 有关代表性部件号，请参阅后面板
- 订购目录1773095，“高速背板连接器”
- 网站：<http://hs3.te.com>



MULTIGIG RT连接器

- 高达6.25 Gb / s的性能
- 每层2个版本可提供密度：分别为0.8"和1"
20.32毫米（0.8"）和25.4毫米（1"）槽距
- VME标准中规定的背板连接器系统：VXS（VITA 41）&
VPX（VITA 46）
- 无针背板连接器采用PCB结构，
连接器系统具有极高的灵活性。100欧姆差分，50欧姆
单端，开放引脚场和功率晶片可以在一个内部混合
连接器模块。
- 有关代表性部件号，请参阅后面板
- 订购目录1773095，“高速背板连接器”
- 网站：<http://www.multigigrt.com>



IMPACT连接器

- 高达25 Gb / s的性能
- 密度高达每厘米32个高速差分对（每英寸80 DP）
- 100欧姆
- 模块化系统：可提供2,3,4,5,6对/柱. 6至20列以2列为增量提供
- 有关代表性部件号，请参阅后面板
- 订购目录7-1773458-1，“IMPACT背板连接器系统”
- 网站：www.te.com/products/Impact



Z-PACK TinMan 100欧姆和85欧姆连接器

- 高达12.5 Gb / s的性能
- 每厘米密度高达14个高速差分对（每英寸80 DP）；6-16列可用
- 模块化系统：3,4,5和6对/列，分别装配16.25毫米（.625"），20.32毫米（0.8"）和25.4毫米（1"）槽距
- 适用于QPCle和Intel QPI标准的85欧姆阻抗版本等85欧姆系统应用
- 有关代表性部件号，请参阅后面板
- 订购目录1773095，“高速背板连接器”
- 网站：<http://www.te.com/ZPackTinMan>



Z-PACK Slim uHD连接器

- 2个版本
 - CS（通用速度）8 Gb / s
 - HS（高速）12.5 Gb / s，可扩展至20 Gb / s
- 密度（2 DP /列分配）：每厘米55行，每英寸141行（在SE任务中）
- 低调 - 12.5毫米宽
- 灵活的引脚分配
- 有关代表性部件号，请参阅后面板
- 订购目录1773095，“高速背板连接器”
- 网站：<http://www.te.com/products/zpackuhd>

高速背板互连

一旦确定了最适合您的需求的连接器描述，请使用下面的图表找到一个零件号码来搜索TE网站。

连接器说明	代表零件编号	
	插头	容器
STRADA Whisper连接器	2149967-3	2149968-3
Z-Pack HM-Zd连接器和Z-Pack Hm-Zd Plus连接器	6469002-1	6469001-1
Z-Pack HS3连接器	5120658-1	5120790-1
MULTIGIG RT连接器	1410187-3	1410142-1
IMPACT连接器	2007777-1	2007703-1
Z-Pack TinMan 100欧姆和85欧姆连接器	1934269-1	1934218-1
Z-Pack超薄UHD连接器	2042088-2	1982738-2

了解更多信息

TE技术支持中心

美国： +1 (800) 522-6752
加拿大： +1 (905) 475-6222
墨西哥： +52 (0) 55-1106-0800
拉丁/ S.美国： +54 (0) 11-4733-2200
德国： +49 (0) 6251-133-1999
英国： +44 (0) 800-267666
法国： +33 (0) 1-3420-8686
荷兰： +31 (0) 73-6246-999
中国： +86 (0) 400-820-6015

本手册中的部件号符合RoHS*，除非另有说明。
*定义为www.te.com/leadfree

te.com

©2011泰科电子公司，TE Connectivity有限公司.版权所有。
1654263-1 CIS LUG FP 3M 08/2011

MULTIGIG RT, TE Connectivity, TE连接 (徽标), Z-PACK和Z-PACK TinMan是商标.其他徽标, 产品和/或公司名称可能是其各自所有者的商标.

Advanced TCA是PICMG-PCI工业计算机制造集团的商标.

Ansys HFSS是Ansoft Corporation的商标.

CST Microwave Studio是CST Computer Simulation Technology AG的商标.

IMPACT是Molex Inc.的商标

MATLAB是The MathWorks, Inc.的商标.

VITA是VMEbus国际贸易协会的商标.

虽然TE已尽一切合理努力确保本手册中信息的准确性，但TE并不保证它是正确的。没有错误，TE也不对任何信息其他陈述，提供担保。信息是准确的，正确的，可靠的或最新的。TE保留随时对此类信息进行调整的权利，恕不另行通知。TE明确放弃所有对本页所包含信息的隐含担保，包括但不限于对适销性或任何其他隐含的担保。符合特定目的。本目录中的尺寸仅供参考，如有更改，恕不另行通知。规格如有更改，恕不另行通知。请向TE咨询最新的尺寸和设计规格。

